

Title (en)

Method for removing at least one brittle layer from a substrate

Title (de)

Verfahren zur Entfernung mindestens einer spröden Schicht von einem Substrat

Title (fr)

Procédé d'enlèvement d'au moins une couche cassante d'un substrat

Publication

**EP 1445040 A1 20040811 (DE)**

Application

**EP 03000755 A 20030113**

Priority

EP 03000755 A 20030113

Abstract (en)

The coating removal process can remove at least a brittle coating (7) from a substrate (4) by means of thermal shock at a temperature (T) considerably above room temperature (RT) without damaging the substrate. The thermal shock causes the growth of a crack system in the brittle layer, thus at least partly separating it from the substrate.

Abstract (de)

Verfahren zur Entfernung von zumindest einer Schicht von einem Substrat nach dem Stand der Technik haben den Nachteil, dass das Substrat in ungewünschter Weise beschädigt wird. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht die Entfernung zumindest einer spröden Schicht (7,10) von einem Substrat durch einen Thermoschock, wobei das Substrat (4) nicht geschädigt wird. <IMAGE>

IPC 1-7

**B08B 7/00**; F01D 5/00

IPC 8 full level

**B08B 7/00** (2006.01); **C23G 5/00** (2006.01)

CPC (source: EP)

**B08B 7/00** (2013.01); **B08B 7/0064** (2013.01); **C23G 5/00** (2013.01)

Citation (search report)

- [X] US 5614054 A 19970325 - REEVES JIM D [US], et al
- [X] EP 0628358 A1 19941214 - GAGNERAUD PERE & FILS [FR]
- [XA] US 4705574 A 19871110 - BURCKHARDT KLAUS A [US], et al
- [X] FR 2377017 A1 19780804 - MURRE JEAN PIERRE [FR]

Cited by

EP2716788A1; EP2110517A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

**EP 1445040 A1 20040811**

DOCDB simple family (application)

**EP 03000755 A 20030113**